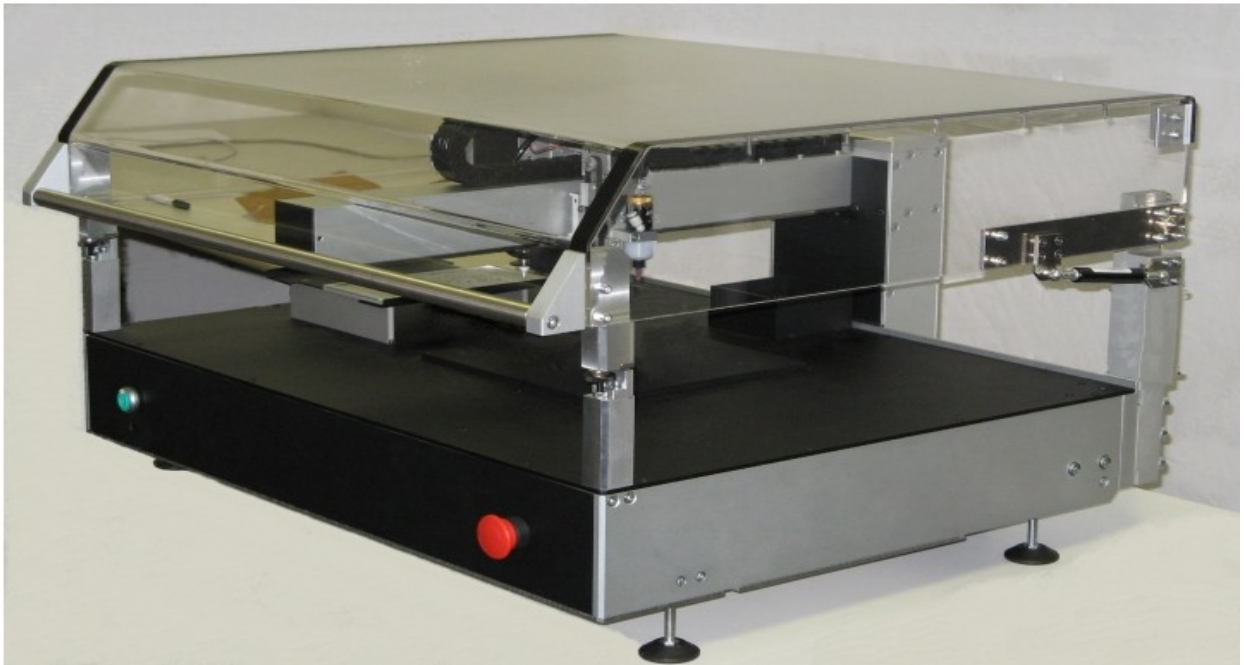


P30 - automat do montażu SMD z głowicą dyspensera



DANE TECHNICZNE

- **Zakres ruchu głowicy**
- max. 400x500mm
- **Rodzaj i wielkość elementów**
- od 0402 do 15x15
- min pitch 0,4mm
- BGA / μ BGA
- **Rodzaj opakowania elementów**
- taśmy / stangi / tacki / elementy luzem
- **Centrowanie elementów**
- bezstykowo - kamera
- **Wydajność automatu**
- do 1200 el/godz
- **Wydajność dyspensera**
- do 8000 dot/godz
- **Ilość podajników**
- max 80 x 8mm – podajnik taśmowy semiautomat
- and 2 x (300 x 200mm) - IC-tray
- with 200 x 300mm PCB size
- **Rozdzielczość**
- dla osi X / Y - 0,008mm
- **Dokładność pozycjonowania**
- +/- 0,08mm
- **Wymiary i waga**
- 840 x 630 x 430 mm / ca. 65 kg
- **Zasilanie**
- 230V-50Hz -350W / 0,6 MPa - 15l/min

CHARAKTERYSTYKA

- automat do montażu SMD – typ:desktop
- automatyczna głowica układająca
- automatyczna głowica dozująca
- automatyczna korekcja punktów referencyjnych
- automatyczny kamerowy system centrowania elementów
- edytor plików CAD oraz Gerbera
- teach-in mode – elektroniczny manipulator
- automatyczny system analizy obrazu
- system operacyjny: Windows XP
- wprowadzanie danych: klawiatura PC / mysz
- panel użytkownika - PC oraz 17" monitor LCD
- **Zastosowanie**
- produkcja prototypowa i małoseryjna
- przeznaczony do układania standardowych elementów SMD włącznie z "finepitch" oraz BGA i μ BGA